

烟台德邦科技股份有限公司

关于对外投资设立新加坡全资子公司的公告

本公司董事会及除解海华之外的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：德邦科技国际有限公司（英文名称：Darbond Technology International Co., Ltd.）
- 注册金额：150万美元
- 本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组。
- 风险提示：本次对外投资设立新加坡全资子公司事宜尚未完成市场监督管理部门登记注册，存在一定的不确定性；新加坡全资子公司成立后可能面临市场风险、运营风险、行业经营环境变化风险等，未来经营状况存在不确定性的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

为进一步优化战略布局，拓宽海外市场业务，烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对外投资不超过150万美元（以最终实际投资金额为准），用于在新加坡新设全资子公司德邦科技国际有限公司（以下简称“德邦国际”），并拟以其为投资主体在越南设立孙公司，本次投资事项尚需获得国内的境外投资主管机关的备案或审批。本次投资后，公司将持有德邦国际100%的股权。

（二）对外投资的决策与审批程序

公司于2023年4月21日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于对外投资设立新加坡全资子公司的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

(三) 本次对外投资设立全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》所规定的重大资产重组情形。

二、投资标的基本情况

标的拟用中文名称：德邦科技国际有限公司

标的拟用英文名称：Darbond Technology International Co., Ltd.

注册资本：150万美元

出资方式：货币

经营范围：研发、生产、销售：应用于集成电路、半导体、电子组装、高效新能源、先进制造等领域的封装材料、导电材料、导热材料、电磁屏蔽材料、结构粘合材料、密封材料等新材料产品，并提供与产品相关的技术咨询与服务、应用与整体解决方案、关联设备等；经营相关货物或技术进出口业务；国际贸易；厂房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

持股比例：公司持股比例为100%。

出资方式：自有资金。

以上信息最终以相关政府部门备案及核准登记为准。

三、本次投资对公司的影响

公司以设立德邦国际为契机，积极拓展国外市场，扩大国际化业务规模，提升品牌竞争力和影响力，符合公司及全体股东利益。本次对外投资设立新加坡全资子公司，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

四、本次对外投资的风险

1、本次投资事项尚需获得国内的境外投资主管机关的备案或审批，存在一定的不确定性。

2、德邦国际成立后可能面临宏观经济及行业政策变化、行业供需及市场竞争、经营不达预期等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理

风险等。

公司将密切关注德邦国际的设立及后续进展，加强风险防范运行机制，依托前期积累的经营管理经验，提高管理能力和经营效率，以不断适应新的业务要求及市场变化。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

烟台德邦科技股份有限公司董事会

2023年04月22日